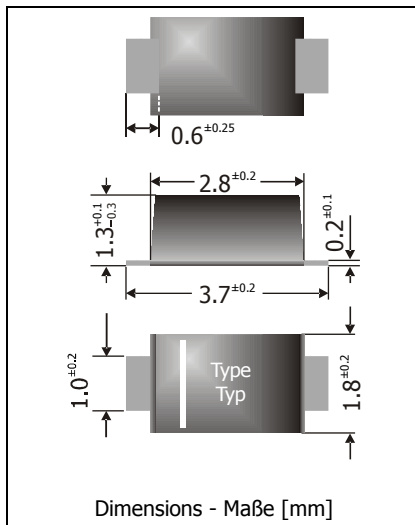



SKL12 ... SKL110

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes Schottky-Gleichrichterdiodes für die Oberflächenmontage

Version 2014-12-10



Nominal current Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...100 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOD-123FL
Weight approx. Gewicht ca.	0.02g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	 Green Molding Halogen-Free
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings

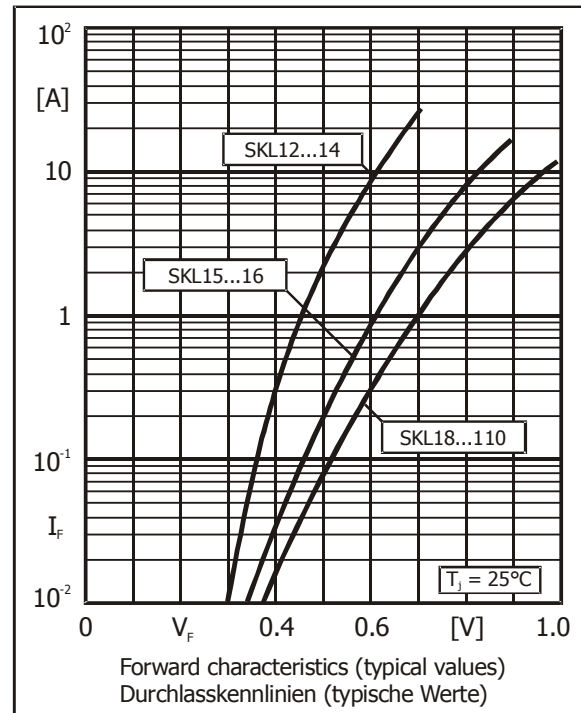
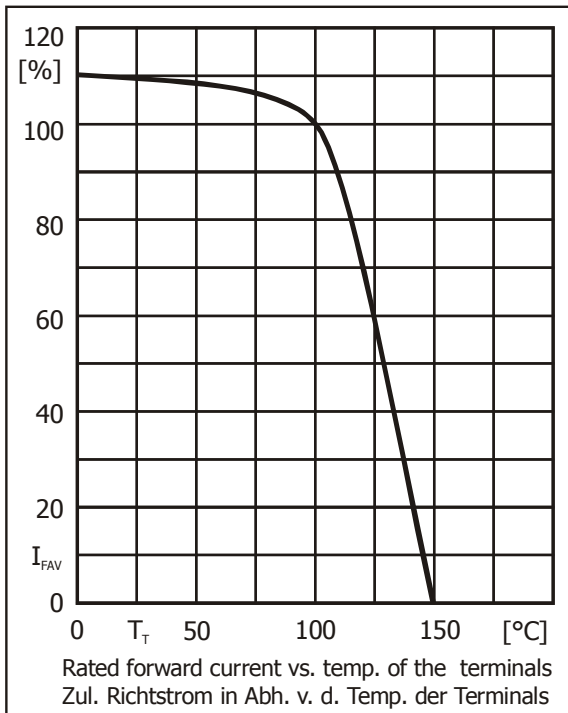
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾
SKL12	20	20	< 0.55
SKL13	30	30	< 0.55
SKL14	40	40	< 0.55
SKL15	50	50	< 0.70
SKL16	60	60	< 0.70
SKL18	80	80	< 0.85
SKL110	100	100	< 0.85

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	4 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	22/25 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	2.4 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 $I_F = 1$ A, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 2 Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 200 μA typ. 2.0 mA
Junction Capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 6\text{ V}$	$f = 1\text{ MHz}$	C_j	typ. 90 pF
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft				R_{thA} < 110 K/W ¹⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss				R_{thT} < 40 K/W



1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss